

鸿合科技股份有限公司

关于预计2020年度公司及子公司向银行申请

综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“公司”）于2020年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准实施。现将情况公告如下：

一、拟申请的综合授信额度情况

为促进公司持续、健康发展，满足公司在生产经营和投资建设中的实际业务需求及资金筹划，公司及子公司拟在2020年度向银行申请总额不超过人民币或等值外币14亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体情况如下：

公司名称	授信额度(万元)
鸿合科技股份有限公司	90,000
北京鸿合新线技术有限公司	10,000
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	40,000
合计	140,000

二、拟申请综合授信的其他情况

1、上述综合授信额度的申请有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日。在综合授信额度内公司可以根据公司及控股子公司的需求调整实际申请综合授信额度。

2、本次综合授信额度不等于公司实际融资金额。在授信额度内的实际借款金额以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会授权经营管

理层在授信额度总额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。

三、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司及子公司为满足自身经营发展的需要，向银行等金融机构申请综合授信业务，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们同意公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2020年4月20日